Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXP57453AM
Premium CPU OBSŁ. 2048DI/O 256AI/O FIPIO



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub komponentu	Podwójny moduł procesora
Oznaczenie oprogramowania	PL7 Junior/Pro

Parametry uzupełniające

Liczba racków	16 4/6/8 sloty 8 12 slotów
Liczba slotów	96 64 128
Pojemnosc procesora WE/Wy dyskretnych	2040 WE/WY
Pojemność analogowego procesora WE/WY	256 WE/WY
Liczba zastosowań na konkretny kanał	64
Liczba kanałów sterujących procesem	20 do 60 prostych pętli
Połączenie typu zintegrowanego	Manager Fipiio (127 agentów) SUB-D 9 złącze Nieizolowane połączenie szeregowe 2 żeńskie mini DIN złącze (19.2/115 kbit/s)
Procesor modułu komunikacyjnego	2 moduły Fieldbus (1 jeśli CANopen jest w użyciu) 8 moduły magistrali AS-Interface 1 CANopen 4 moduł sieciowy
Opis pamięci	Wewnętrzna pamięć RAM (z kartą PCMCIA) 176 Kstów dane Wewnętrzna pamięć RAM (bez karty PCMCIA) 96 Kstów program i dane Karta PCMCIA 2048 Kstów dodatkowa przestrzeń do przechowywania danych Karta PCMCIA 992 Kstów program
Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu	30.5 %MWi słów wewnętrznych lokalne dane wewnętrzne 32 %KWi słów stałych lokalne dane wewnętrzne 32768 %Mi lokalne bity wewnętrzne
Struktura aplikacji	64 zdarzeń zadaniowych 1 szybkie zadanie 1 zadanie główne
Czas wykonania na instrukcję	0.06 µs Boole'owski z kartą PCMCIA 0.06 µs Boole'owski bez karty PCMCIA 0.08 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa z kartą PCMCIA 0.08 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa bez karty PCMCIA 1.7 µs zmienne punkty z kartą PCMCIA 1.7 µs zmienne punkty bez karty PCMCIA
Liczba rozkazów na ms	13.82 Kinst/ms 100 % Boole'owski z kartą PCMCIA 13.82 Kinst/ms 100 % Boole'owski bez karty PCMCIA 8.8 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka z kartą PCMCIA 8.8 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka bez karty PCMCIA
Układ napowietrzny	0,22 Ms dla szybkie zadanie 1,15 ms dla zadanie nadrzędne
Oznakowanie	CE

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Sygnalizacja lokalna	Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony) Aktywność w magistrali Fipio (FIP): 1 LED (czerwony) Błąd konfiguracji modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) Aktywność w porcie (TER): 1 LED (żółty)
Obciążenie prądowe	1080 mA w 5 V DC
Format modułowy	Podówjny
Masa produktu	0,56 kg

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 nr 142 92/31/EEC CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C 89/336/EEC CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D
Certyfikaty produktu	BV ABS RINA RMRS DNV GL LR
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Wilgotność względna	10…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas pracy 5…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas przechowywania
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	648,0 g

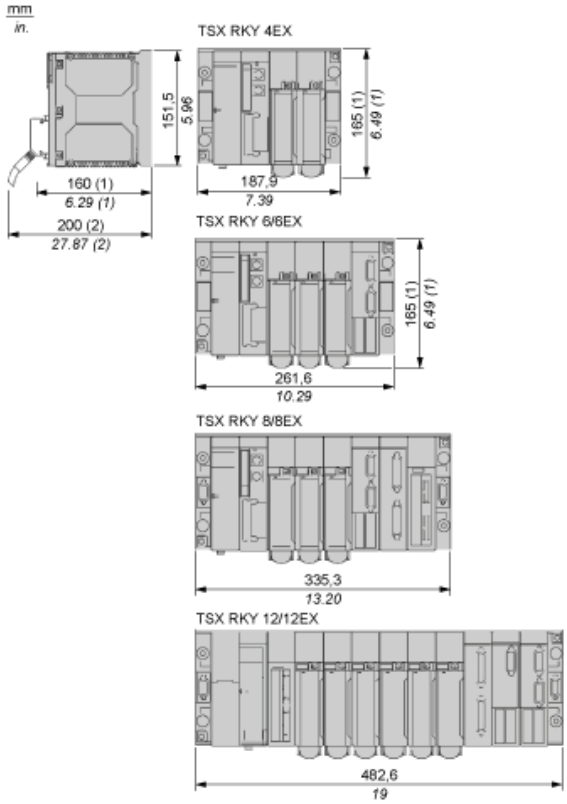
Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.